

UDC 621.382
L 32



中华人民共和国国家标准

GB 7423.1—87

半导体器件散热器 通用技术条件

Heat sink of semiconductor devices
Generic specification

1987-03-16 发布

1987-11-01 实施

国家标准局 发布

半导体器件散热器 通用技术条件

Heat sink of semiconductor devices Generic specification

本标准规定了半导体器件散热器的型号编制方法、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于电子设备用半导体器件（以下简称器件）散热器。

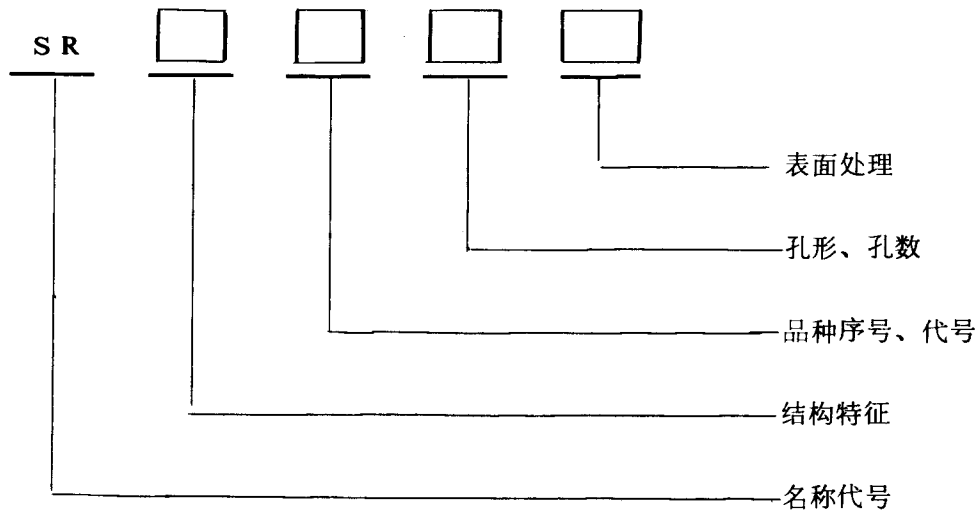
1 符号意义

- T_f —散热器最高温度点的温度，K；
- T_a —散热器周围环境的平均温度，K；
- ΔT_{fa} —散热器最高温度点的温度与周围环境平均温度之差，K；
- P_c —器件的热耗散功率，W；
- R_{Tf} —散热器热阻，K/W；
- v —流过散热器表面的平均风速，m/s。

2 型号的编制方法及标记示例

2.1 型号编制方法

散热器型号的编制由五部分组成，排列顺序如下：



2.1.1 名称代号

字母SR 分别表示散热器名称中“散”、“热”汉语拼音的首字母。

2.1.2 结构特征

散热器的结构特征用汉语拼音的首字母表示，其代号按有关散热器产品标准型号编制方法中结构特征的规定。